

Informationen zur Halbleiter-Fertigung bei Bosch

- ▶ **Aktuelles Portfolio**
Beschleunigungs-, Drehraten-, Massenfluss-, Druck- und Umweltsensoren sowie Mikrofone, Leistungshalbleiter und anwendungsspezifische Schaltungen (ASICs) für Fahrzeugsteuergeräte
- ▶ **Fertigungsstandorte**
Reutlingen, Baden-Württemberg (150mm- und 200mm-Technologie)
- ▶ **Produktion**
Aus Reutlingen fertigt Bosch täglich rund 4,5 Millionen MEMS-Komponenten und rund 1,5 Millionen ASICs
- ▶ **Vertrieb**
Bosch Sensoren im Gegensatz zu den Halbleitern werden nicht nur für den Eigenbedarf gefertigt, sondern zum größten Teil vermarktet
- ▶ **Patente**
Bosch hält mehr als 1 000 Patente und Patentanmeldungen im Bereich der MEMS-Technologie
- ▶ **Auszeichnung**
Deutscher Zukunftspreis 2008 für den Durchbruch in der „Oberflächen-Mikromechanik“
- ▶ **Historie**
Seit mehr als 45 Jahren entwickelt mikroelektronische Bauteile und Systeme; vor 20 Jahren hat Bosch den Halbleiter-Fertigungsprozess für mikroelektromechanische Systeme (MEMS) entwickelt und ist heute einer der führenden Hersteller